

TUGAS AKHIR

PERBAIKAN KUALITAS DECK MODEL BLURAY DISC PLAYER MENGGUNAKAN METODOLOGI SIX SIGMA DMAIC

(STUDY KASUS DI PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA)

Program Sarjana S1



NAMA : ROMI CAHYANA

NIM : 41608110004

PROGRAM STUDI : TEKNIK INDUSTRI

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2012

LEMBAR PENGESAHAN

Perbaikan Kualitas Deck Model Bluray Disc Player Menggunakan Metodologi Six Sigma DMAIC (Studi Kasus di PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA)

Disusun Oleh :

Nama	:	Romi Cahyana
NIM	:	41608110004
Jurusan	:	Teknik Industri
Lokasi Pengambilan Data	:	Cikarang Industrial Estate Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang Bekasi 17530
Waktu Pelaksanaan TA	:	01 April 2012
Waktu Penyelesaian Laporan TA	:	30 Juli 2012

Telah disetujui dan diterima sebagai syarat kelulusan Tugas Akhir

U N I V E R S I T A T
MERCU BUANA
Universitas Mercu Buana
Jakarta

Menyetujui


Ir. Muhammad Kholil, MT
Dosen Pembimbing

Mengetahui



Ir. Muhammad Kholil, MT
Koordinator Tugas Akhir

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romi Cahyana

NIK : 41608110004

Jurusan : Teknik Industri

Fakultas : Teknik

Judul Skripsi : Perbaikan Kualitas Deck Model Bluray Disc Player

Menggunakan Metodologi Six Sigma DMAIC

(Studi Kasus di PT. Samsung Electronics Indonesia)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Mercu Buana Jakarta.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

Jakarta, 31 July 2012

Penulis,


METERAI TEMPEL
POSTA INDONESIA TEGAL 20110
SNED5ABF142007740
6000 DJP
(Romi Cahyana)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penyusun mengucapkan Alhamdullillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Laporan Tugas Akhir yang berjudul "*Perbaikan Kualitas Deck Model Bluray Disc Player Menggunakan Metodologi Six Sigma DMAIC di PT.Samsung Electronics Indonesia*" ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Dalam menyusun laporan ini banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

- Allah SWT yang telah melimpahkan banyak karunia kepada penulis sehingga sampai saat ini bisa menyelesaikan perkuliahan sampai dengan penyelesaian tugas akhir ini dan semoga diberikan kelancaran dan keberhasilan pada saat sidang nanti.
- Keluarga besar Bapak Djuhana Sofyan di Bandung meliputi ayah, ibu, kakak, adek, ipar, keponakan yang selalu mendoakan kelancaran, kemudahan dalam proses perkuliahan penulis.
- Istri dan putra tercinta yang selalu mengingatkan dan memberikan Doa yang tak henti-henti pada penulis untuk menyelesaikan Laporan TA ini.
- Bapak Muhammad Kholil, ST.MT, sebagai pembimbing yang telah memberikan banyak petunjuk, ide dan bantuan yang berharga.
- Seluruh staff dan pengajar Jurusan teknik Industri Universitas Mercu Buana yang telah memberi cukup banyak ilmu.

- Sr. Manager Quality Control (QC) yang dipimpin oleh Bapak Firman Taurus, Pak Djoko Prasetyo selaku supervisor untuk VD produk dan seluruh karyawan Departemen IQC yang banyak membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
- Rekan kerja baik senior maupun junior yang sering penulis tanya apabila menemui kesulitan dalam perkuliahan sampai penyusunan laporan tugas akhir ini.
- Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Kritik dan saran penulis harapkan guna penyempurnaan Laporan Tugas Akhir ini.

Cikarang, 30 Juli 2012



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Pembatasan Masalah	2
1.5 Metodologi Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	3

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Proses Produksi	5
2.1.1 Proses Produksi	5
2.1.2 Jenis Proses Produksi	5
2.2 Sistem Manufaktur	7
2.2.1 Operasi Sistem Manufaktur	9
2.2.2 Design Respon terhadap Permintaan Konsumen	11
2.2.3 Strategi Desain Proses Manufaktur	13
2.3 Pengendalian Kualitas	15
2.3.1 Pengertian Kualitas	15
2.3.2 Pengendalian Kualitas	17
2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas	18
2.3.4 Pelaksanaan Pengendalian Kualitas	21
2.4 Six Sigma	23
2.4.1 Konsep Six Sigma	24
2.4.2 Sejarah Six Sigma	25
2.4.3 Karakteristik Six Sigma	27
2.4.4 Fondasi Six Sigma	28
2.4.5 DMADV atau DFSS	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Persiapan Penelitian	36
3.2 Identifikasi Masalah	36
3.3 Pengumpulan Data	37
3.4 Pengolahan Data	39

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Gambaran Umum Perusahaan	41
4.1.1 Jenis Produk	43
4.1.2 Optical Pick Up	45
4.1.3 Assy Bluray Deck	48
4.2 Define Phase	49
4.2.1 Latar Belakang Proyek	50
4.2.2 Pernyataan Permasalahan	53
4.2.2 Tujuan Proyek	54
4.3 Measure Phase	54
4.3.1 Uji Kecukupan Data	54
4.3.2 Uji Keseragaman Data	55
4.3.3 Perhitungan Nilai Sigma	54
4.3.4 Pareto Chart	61
4.3.5 Mapping Proses	66
4.3.6 Fishbone Diagram	68
4.3.7 Function Deployment Matrix	70

BAB V ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analyze Phase	74
5.1.1 Analisa Hipotesa Potensial X's	75
5.2 Improve Phase	91
5.2.1 Perbaikan Potensial X's	91
5.3 Control Phase	91
5.3.1 Analisa Pareto	104
5.3.2 Data Cacat Deck Trimester Kedua	105

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	106
6.2 Saran	108

DAFTAR PUSTAKA..... 109

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

D A F T A R T A B E L

Tabel 4.1 Data Cacat Januari sampai dengan Maret	50
Tabel 4.2 Data Cacat Wk1- Wk13.....	53
Tabel 4.3 Perhitungan LCL, CL dan UCL	57
Tabel 4.4 Konversi Six Sigma	60
Tabel 4.5 Hasil Analisa Pareto	62
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan FDM Matrik	71
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Perhitungan Prioritas FDM Matrik	72
Tabel 5.1 Hipotesa Main Frame	76
Tabel 5.2 Hipotesa FPC	77
Tabel 5.3 Hipotesa Tray Disc	78
Tabel 5.4 Hipotesa Packing Sistem	80
Tabel 5.5 Hipotesa Timah Spindle Motor	81
Tabel 5.6 Hipotesa Folding FPC	82
Tabel 5.7 Hipotesa Screw Spindle Motor	83
Tabel 5.8 Hipotesa Work Station	84
Tabel 5.9 Hipotesa Temperatur Mesin Solder	85
Tabel 5.10 Hipotesa Konduktor FFC	86
Tabel 5.11 Hipotesa Deck Terdapat Excess Material	88
Tabel 5.12 Hipotesa Bracket Deck Tidak Rata.....	89
Tabel 5.13 Hipotesa Jig Touch Up	90
Tabel 5.14 Hasil Analisa Pareto Chart	104
Tabel 5.15 Data Cacat Deck Apr-Jun '12	105

D A F T A R G A M B A R

Gambar 4.1 Produk Set Top Box (STB).....	43
Gambar 4.2 Produk Home Appliance	44
Gambar 4.3 Produk Bluray Disc Optical Pick Up dan Deck	44
Gambar 4.4 Fungsi Optical Pick Up Unit	45
Gambar 4.5 Proses Kerja Optical Pick Up	46
Gambar 4.6 Susunan Komponen-komponen Optical Pick Up	47
Gambar 4.7 Sejarah Perkembangan Media Disc	48
Gambar 4.8 Susunan Komponen-komponen Deck	49
Gambar 4.8 Susunan Komponen-komponen Deck	49
Gambar 4.9 Grafik Cacat Januari – Maret ‘12	50
Gambar 4.10 Grafik Keseragaman Data	57
Gambar 4.10 Grafik Keseragaman Data	57
Gambar 4.11 Pareto Chart Cacat Deck	62
Gambar 4.12 Cacat Noise	63
Gambar 4.13 Cacat Elektrikal	64
Gambar 4.14 Cacat Skew NG	64
Gambar 4.15 Cacat Open Close Fail	65
Gambar 4.16 Cacat No Play	65

Gambar 4.17 Proses Map Deck	67
Gambar 4.18 Diagram Sebab Akibat Cacat Deck	69
Gambar 5.1 Main Frame NG Bending	92
Gambar 5.2 Perbaikan Main Frame NG	92
Gambar 5.3 Soldering FPC Gap	93
Gambar 5.4 Perbaikan Tape FPC	93
Gambar 5.5 Tray Disc NG Bending	94
Gambar 5.6 Perbaikan Tray Disc	94
Gambar 5.7 Perbaikan Sistem Packing	95
Gambar 5.8 Soldering FPC Floating	95
Gambar 5.9 Perbaikan Solder PAD Spindle Motor	96
Gambar 5.10 Perbaikan Folding FPC	96
Gambar 5.11 Perbaikan Screw Spindle Gap	97
Gambar 5.12 Perbaikan Work Station	98
Gambar 5.13 Perbaikan Pengontrolan Temperatur Mesin Solder	99
Gambar 5.14 Perbaikan Pengontrolan Temperatur Heating Roll	99
Gambar 5.15 Excess Material	100
Gambar 5.16 Perbaikan Excess Material	100
Gambar 5.17 Perbaikan Bracket Deck	101
Gambar 5.18 Standarisasi Jig Touch Up	102
Gambar 5.19 Pengontrolan Hasil Pergantian Pisau	102
Gambar 5.20 Perubahan Instruksi Kerja Proses Cutting	103
Gambar 5.21 Pareto Cacat Deck Trimester Kedua	104
Gambar 5.22 Grafik Cacat Deck Jan – Juni 2012	104